

IT NEWS - Settembre/3

(2004)

LA CASSAFORMA AUTOPORTANTE

La cassaforma è uno stampo, generalmente realizzato in legno, all'interno del quale viene versato il cemento per formare un muro. Le casseforme vengono rimosse una volta che la costruzione o parte di essa viene completata; tuttavia, a causa dell'usura legata sia agli eventi atmosferici che alle normali operazioni di montaggio e smontaggio, le casseforme possono essere riutilizzate per un numero limitato di volte.

Recentemente, è stata messa a punto una nuova tipologia di cassaforma prefabbricata in cemento che non viene rimossa, bensì entra a far parte della costruzione.

Questo tipo di cassaforma, realizzata con cemento di qualità, oltre a risultare autoportante, presenta innumerevoli vantaggi: è dotata di un'eccezionale qualità superficiale, può essere liscia o strutturata ed è leggera e facile da maneggiare. Inoltre, non essendo necessarie operazioni di rimozione garantisce un risparmio in termini di tempo e di denaro.

(Tratto da Cordis, 20-09-2004)

Per ulteriori informazioni:

http://dbs.cordis.lu/fep-cgi/srchidadb?ACTION=D&SESSION=148502004-10-7&DOC=5&TBL=IT_OFFR&RCN=EN_RCN:1523&CALLER=OFFR_O_BUSI_IT

TECNICA DI PRODUZIONE PER AUMENTARE LA RESSITENZA A COMPRESSIONE DEL CEMENTO

Le attuali tecniche di produzione di cemento OPC (Ordinary Portland Cement) si basano su processi a bassa cinetica con macinazione a tamburo; un'azienda tedesca sta sviluppando un nuovo processo di produzione di cemento detto HEM (High Energy Milling) in grado di ridurre sia le dimensioni delle particelle di OPC che i tempi di produzione.

Riducendo le dimensioni delle particelle e quindi anche gli spazi interstiziali, il cemento diviene più denso e risulta potenzialmente più resistente alla compressione.

Il tradizionale OPC prodotto in tutto il mondo presenta una resistenza alla corrosione di circa 40 MPa dopo 28 giorni di indurimento, le miscele prodotte durante questo studio hanno evidenziato resistenze di circa 32 Mpa il primo giorno e 110 MPa dopo 28 giorni.

(Tratto da Cordis, 06-09-2004)

Per ulteriori informazioni:

http://dbs.cordis.lu/fep-cgi/srchidadb?ACTION=D&SESSION=123252004-10-7&DOC=24&TBL=IT_OFFR&RCN=EN_RCN:1504&CALLER=OFFR_O_BUSI_IT

CONFEZIONAMENTO A BASSO COSTO DI SISTEMI MICROELETTROMECCANICI

I MEMS sono sistemi elettronici miniaturizzati nati dalla microlavorazione del silicio con componenti elettrici, meccanici, ottici e biochimici. Questi dispositivi rappresentano il futuro in molti settori industriali anche se le numerose complessità legate alle interazioni tra i vari componenti e i rigorosi requisiti di montaggio ne limitano in parte la crescita.

Le più tradizionali procedure per il montaggio dei MEMS si basano su operazioni a livello dei wafer e comportano l'incollaggio della fetta di silicio oppure la fabbricazione e l'adesione di membrane

microlavorate al dispositivo che deve essere incapsulato. Sebbene efficienti, queste tecniche risultano ancora molto costose; per questa ragione SUMICAP si è prefissata di sviluppare una tecnica di incapsulamento dei wafer in grado di ridurre le attuali limitazioni tecniche e i costi di produzione. I risultati di questo progetto hanno fornito un'ampia gamma di processi per il montaggio dei MEMS mediante incapsulamento ed hanno contribuito ad arricchire il know-how del settore.

(Tratto da Cordis, 04-10-2004)

Per ulteriori informazioni:

http://dbs.cordis.lu/fep-cgi/srchidadb?ACTION=D&SESSION=123252004-10-7&DOC=2&TBL=IT_OFFR&RCN=EN_RCN:1546&CALLER=OFFR_O_BUSI_IT

Ing. Marco Vanzi
Servizio Innovazione Tecnologica
Unione degli Industriali della Provincia di Bergamo